

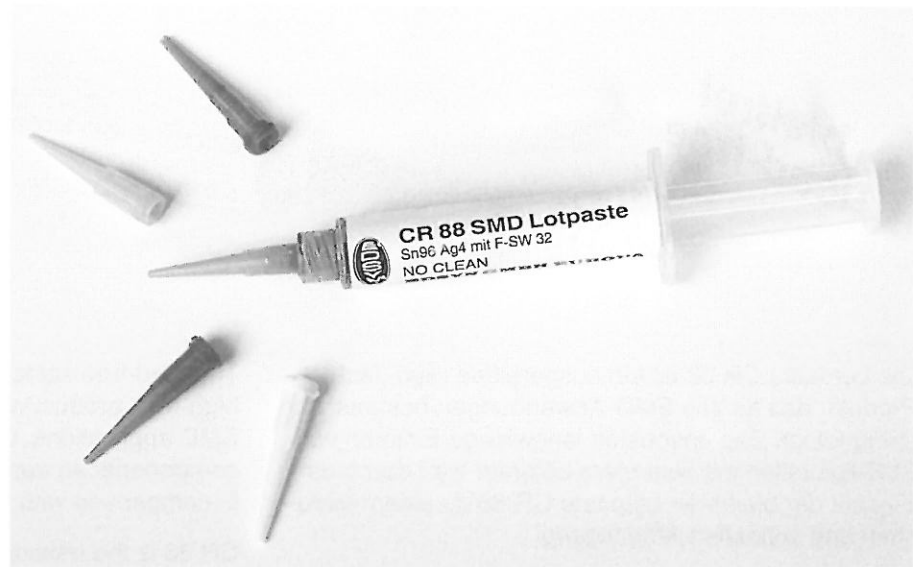
Löten von SMT-Bauteilen / Soldering SMDs

Lotpaste CR 88 / CR 88 Solder paste

Einfache Handhabung - anwenderfreundlich - zeitsparendes Arbeiten beim Löten von SOPs, QFPs, PLCCs, etc.

Ease of application and userfriendliness for timesaving soldering of SOPs, QFPs, PLCCs, etc.

**bleifrei
lead-free**



Verbrauchshinweise:

Nach der Entnahme der Paste muß die Spritze wieder möglichst dicht verschlossen werden. Benutzte Paste sollte nicht mit der frischen zusammen in einem Behälter aufbewahrt werden. Im laufenden Arbeitsprozeß können diese selbstverständlich zusammen verwendet werden. Verschiedene Lotlegierungen und Pastentypen dürfen allerdings nicht vermischt werden.

Vorteile:

- * NO CLEAN - Paste
- * hervorragende Konturenstabilität
- * einfacheres Löten von bleifreien Lötstellen im Vergleich zum Verarbeiten von bleifreien Lötendraht
- * keine Lotkugel- oder Spritzerbildung
- * langzeitige Verarbeitung und lange Lagerzeit möglich
- * hervorragend geeignet für Fine-Pitch-Anwendungen
- * einwandfreie Lötresultate beim Einsatz mit Heißluft und LötKolben
- * verschiedene Größen von konischen Dosier-nadeln

Instructions for use:

After taking out solder paste always close the syringe as tightly as possible. Used and new solder paste can be applied together, but should not be stored in the same container. Do not mix different solder alloys and types of paste.

Advantages:

- * NO CLEAN paste
- * superior definition
- * easy soldering of lead-free soldering joints in comparison to lead-free soldering wire
- * no globule or spatter formation
- * long storage and useful life
- * excellent suitability for fine pitch applications
- * perfect soldering results with hot air tools and soldering irons
- * conical dosing needles in various sizes

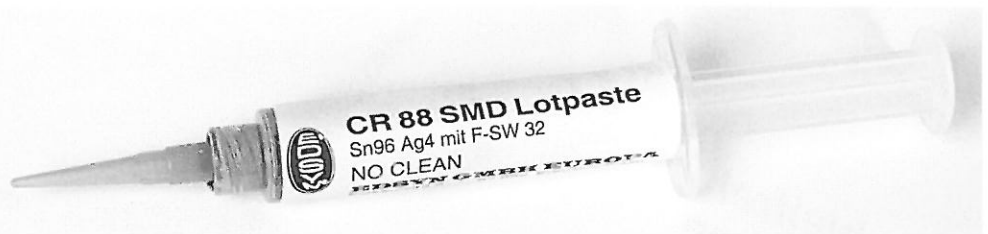
Löten von SMT-Bauteilen / Soldering SMDs

Lotpaste CR 88 / CR 88 Solder paste

Einfache Handhabung - anwenderfreundlich - zeitsparendes Arbeiten beim Löten von SOPs, QFPs, PLCCs, etc.

Ease of application and userfriendliness for timesaving soldering of SOPs, QFPs, PLCCs, etc.

**bleifrei
lead-free**



Die Lotpaste CR 88 ist ein ausgereiftes High-Tech-Produkt, das für alle SMD-Anwendungen bestens geeignet ist. Das ansonsten langwierige Einlöten von SMT-Bauteilen mit bleifreiem Lötendraht wird durch den Einsatz der bleifreien Lotpaste CR 88 zu einem einfachen und schnellen Arbeitsgang.

Ihrer Entwicklung liegt nicht nur langjährige Erfahrung auf dem SMD-Gebiet, sondern auch die sorgfältige und strenge Beachtung der Richtlinien von DIN-, SN-, IPC- und MIL-Normen zugrunde.

Die Flußmittelzusammensetzung entspricht **F-SW 32** oder nach den neuen Normen **RE L0**. Die bleifreie Lotlegierung enthält **Sn 96,5 Ag 3,5**

Qualifikation:

Die Lotpaste CR 88 ist eine RMA-Paste, die den Anforderungen der MIL-QQ-S571e entspricht.

Die entsprechenden Korrosions-, Lotkugel- und Benetzungstests wurden ebenso wie die Konturenstabilitätsprüfung (SN 59650) bestanden. Laboruntersuchungen bestätigen, daß die korrosionsfreien, der FSW 32 entsprechenden Rückstände auf der Leiterplatte bedenkenlos verbleiben können.

Lagerung:

Das ungeöffnete Gebinde kann bei einer Lagerung von 20°C Raumtemperatur 6 Monate gelagert werden. Im geöffneten Zustand ist die maximale Verarbeitungszeit von den Umwelteinflüssen abhängig.

The lead-free solder paste CR 88 is a perfected high-tech product with excellent suitability for all SMD applications. CR 88 makes soldering of SMT components an easy and quick process, especially in comparison with lead-free soldering wire.

CR 88 is the essence of years of experience in the field of SMD applications and was developed to fully and strictly comply with DIN, SN, IPC and MIL standards.

The flux composition complies with **F-SW 32** or according to the new restrictions **RE L0**.

The lead-free solder alloy itself is composed as follows: **Sn 96,5 Ag 3,5**

Qualification:

CR 88 solder paste is an RMA paste which meets the requirements of MIL-QQ-S571e.

CR 88 passed all corrosion, wetting and globule solderability tests under this standard as well as the definition test according to SN 59650. Lab tests have shown that possible residues are non-corrosive, comply with FSW 32 and may safely remain on the printed circuit board.

Storage:

The unopened package has a storage life of 6 months at a room temperature of 20°C. Once opened, the maximum useful life depends on the environmental conditions.